

## 芯联集成电路制造股份有限公司 2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年半年度营业收入约为 28.80 亿元，同比增长约 14.27%。预计 2024 年半年度主营业务收入约为 27.68 亿元，同比增长约 11.51%。
- 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-4.39 亿元，与上年同期相比减亏约 6.70 亿元，同比减亏约 60.43%。
- 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-7.50 亿元，与上年同期相比减亏约 4.31 亿元，同比减亏约 36.50%。
- 公司预计 2024 年半年度 EBITDA（息税折旧摊销前利润）约为 11.34 亿元，与上年同期相比增加约 7.27 亿元，同比增长约 178.45%。

### 一、本期业绩预告情况

#### （一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以下简称“报告期”）。

#### （二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度营业收入约为 28.80 亿元，与上年同期相比增加约 3.60 亿元，同比增长约 14.27%。预计 2024 年半年度主营

业务收入约为 27.68 亿元，与上年同期相比增加约 2.86 亿元，同比增长约 11.51%。

2、公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-4.39 亿元，与上年同期相比减亏约 6.70 亿元，同比减亏约 60.43%。

3、公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-7.50 亿元，与上年同期相比减亏约 4.31 亿元，同比减亏约 36.50%。

4、公司预计 2024 年半年度 EBITDA（息税折旧摊销前利润）约为 11.34 亿元，与上年同期相比增加约 7.27 亿元，同比增长约 178.45%。

（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

## 二、上年同期业绩情况

2023 年半年度：

营业收入：25.20 亿元。

主营业务收入：24.82 亿元。

归属于母公司所有者的净利润：-11.09 亿元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-11.81 亿元[注]。

EBITDA（息税折旧摊销前利润）：4.07 亿元。

注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的最新规定，公司对 2023 年半年度非经常性损益做了调整，因此上述归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也相应做了调整。

## 三、本期业绩变化的主要原因

（一）市场需求旺盛，收入实现较大幅度增长。

2024 年上半年，受益于新能源汽车市场及消费市场的旺盛需求，12 英寸硅基晶圆产品、SiC 产品等新建产线收入的快速增长直接带动了公司收入的提升，公司整体营业收入实现较大幅度增长。从应用领域来看，报告期内，公司车载领域及消费领域收入双增长，其中消费领域收入实现同比翻番增长。从产品结构来看，报告期内，12 英寸硅基晶圆产品收入增长迅速，同比增长 787%。历经 3 年的研发和验证，公司搭建了多个国内唯一或国内稀缺的 12 英寸车规级 BCD 工艺平台，车规级 BCD 产品已进入量产；在 SiC MOSFET 产品方面，上半年公司收入同比增加超 3 亿元，同比增长 329%。

（二）供应链多元化与生产管理优化双助力，提升产品盈利能力。

报告期内，在供应链多元化方面，公司通过与供应商的战略合作和协同，原材料、零部件的成本持续降低，产品盈利能力不断提升。在优化生产管理方面，公司通过数据系统化、设备自动化等方式实现精细化管理，生产效率显著提高；同时通过持续的工艺步骤、工艺条件的优化，大幅提升产品的市场竞争力。报告期内，公司 EBITDA（息税折旧摊销前利润）约为 11.34 亿元，较去年同期增加约 7.27 亿元，同比增长约 178%。

#### 四、风险提示

截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

#### 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年7月13日